

お客様各位



2025 年 10 月吉日  
エスペック株式会社

## エスペック信頼性セミナー2025 のご案内

拝啓 貴社ますますご盛栄のこととお喜び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

今般半導体は IC、マイクロプロセッサ、PC、スマートフォン、AI・クラウド、さらには EV・宇宙・次世代材料へ搭載され、現代社会に欠かすことのできない基盤技術となっております。

このたび「エスペック信頼セミナー2025」では、先端半導体製造技術についてご紹介するオンラインセミナーを開催いたします。

秋冷の候、ご多用とは存じますが是非聴講頂ければ幸いです。皆様のお申し込みを心よりお待ちしております。  
敬具

記

### 開催要項

日 時 : 2025 年 11 月 27 日 (木) 13:30~16:30

場 所 : オンラインでの開催 (事前申込が必要です)

テ マ : 『次世代 (先端) 半導体製造技術の展望』

受 講 料 : 無料

申込方法 : 下記 URL の WEB サイトよりお申し込みください。

セミナー会場への入場には弊社から別途ご案内する入場キー(URL)が必要となりますので、必ず以下のお申し込みフォームへ登録をお願いします。

締切日 : 2025 年 11 月 20 日 (木)

## ■ お申し込みフォームはコチラ ↓ ↓ ■

[https://espec.satori.site/reliability\\_seminar](https://espec.satori.site/reliability_seminar)

\* 先着順での受付となりますのでお早めに申し込みください。

\* 当社同業の企業様からの申し込みはご遠慮いただく場合がございます。予めご了承ください。

<問合せ先>

エスペック信頼性セミナー2025 事務局 (くやま 久山)

[Mail] [salesplanning\\_share@espec.co.jp](mailto:salesplanning_share@espec.co.jp)

[Tel] 070-2448-8050

## 講演概要

本セミナーでは、先端半導体パッケージング技術に関する最新の研究成果、半導体デバイスおよび材料における信頼性試験の最新の評価事例、チップレット技術の次世代応用とその展望についてご紹介いただきます。

\* 講演内容・発表者は変更する場合がございます。

### 〔招待講演 1〕

#### ▶先端半導体パッケージの技術動向とレゾナックの共創戦略

発表：株式会社レゾナック・ホールディングス 執行役員 半導体材料研究開発統括  
株式会社レゾナック エレクトロニクス事業本部 副本部長 阿部 秀則 様



##### 「概要」

レゾナックは共創型化学会社として、AI 半導体の進化を支える先端パッケージング技術と材料イノベーションに取り組んでいます。本講演では、注目を集める半導体後工程の技術動向と、材料開発を加速するコンソーシアム「JOINT2」の活動成果について解説します。

国内外の材料・基板・装置メーカーとの連携事例を通じて、先端パッケージの組み立てで得られた技術的知見や信頼性評価の結果を紹介します。併せて、新たに始動した共創活動「JOINT3」の取り組みと今後の展望についても紹介します。

### 〔一般講演〕

#### ▶半導体デバイス・材料における信頼性試験の最新動向と評価事例

発表：エスベック株式会社 カスタム機器本部 SI 部 開発設計グループ 徳永 裕太



##### 「概要」

AI 関連技術の急速な成長や車両の電動化・自動運転技術の進展に伴い、半導体デバイスの微細化・高性能化が加速しています。その一方で、熱マネジメントや接合部・絶縁部の信頼性確保といった課題が顕在化しています。本発表では、こうした先端半導体デバイスや材料における信頼性評価の試験ニーズと、最新の評価事例を紹介します。

### 〔招待講演 2〕

#### ▶先端半導体後工程の開発動向と展望

発表：横浜国立大学 半導体量子集積エレクトロニクス研究センター  
副センター長 井上 史大 様



##### 「概要」

半導体の進化に伴い、複数のチップを組み合わせる高性能化を図るチップレット技術が注目されている。3D/2.5D 実装やハイブリッドボンディング、再構成 D2W、BSPDN などの新技術により、小型・高効率な集積が可能となりつつあります。本講演では、これらの最新動向を俯瞰し、次世代の応用や展望を紹介します。

以上